(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年8 月5 日 (05.08.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/065510 A1

(51) 国際特許分類7: C09J 7/02, H01L 21/02, 21/301, 21/304

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/000450

(22) 国際出願日: 2004 年1 月21 日 (21.01.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-013462 2003 年1 月22 日 (22.01.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３番２３号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀米 克彦 (HORIGOME, Katsuhiko) [DE/JP]; 81925 ミュンヘン デニンガーストラッセ１０２ Munich (DE). 泉 達矢 (IZUMI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒3360026 埼玉県さいたま市南区辻７－７－３－３０３ Saitama (JP). 高橋 和弘 (TAKAHASHI, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒3330866 埼玉県川口市芝５－３－１７ Saitama (JP).

(74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031 東京都品川区西五反田七丁目１３番６号 五反田山崎ビル６階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE SHEET, METHOD OF PROTECTING SEMICONDUCTOR WAFER SURFACE AND METHOD OF PROCESSING WORK

(54) 発明の名称: 粘着シート、半導体ウエハの表面保護方法およびワークの加工方法

(57) Abstract: A pressure sensitive adhesive sheet that even when used in processing including heating or heat generating treatment, would not adhere to other equipment, etc. In particular, a pressure sensitive adhesive sheet of unprecedented high temperature thermal resistance for semiconductor wafer processing, which endowed with properties such as capability of circuit surface protection and expandability, can be used as a surface protective sheet, dicing sheet or pickup sheet. Such a pressure sensitive adhesive sheet is characterized in that it comprises a substrate obtained by forming a first hardening resin into a film and hardening the same and, superimposed on major surfaces thereof, a top coat layer obtained by coating with a second hardening resin and hardening the same and, opposite to the top coat layer, a pressure sensitive adhesive layer.

(57) 要約: 本発明は、加熱処理または発熱を伴う処理を含む加工プロセスに適用されても、他の装置等に密着することがない粘着シートが提供することを目的としている。特に、本発明は、回路面の保護機能やエキスパンド性などの特性を付与して、表面保護シートやダイシングシートあるいはピックアップシートとして使用可能な、従来にない高温耐熱性を備えた半導体ウエハ加工用の粘着シートを提供すること目的としている。本発明に係る粘着シートは、第１の硬化性樹脂を製膜・硬化して得られた基材と、その上に第２の硬化性樹脂が塗布形成され硬化したトップコート層およびその反対面に形成された粘着剤層とからなることを特徴としている。

WO 2004/065510 A1